



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



Grinding Wheels

# GF01 SERIES BT100/BT300

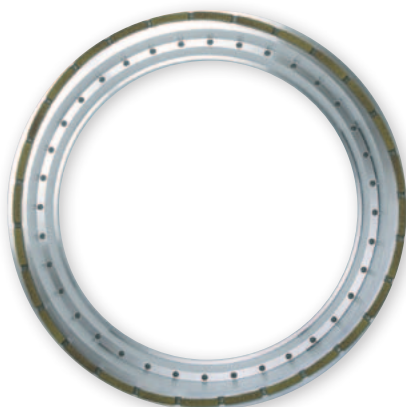
## 高品位加工を追求した1軸用ホイール



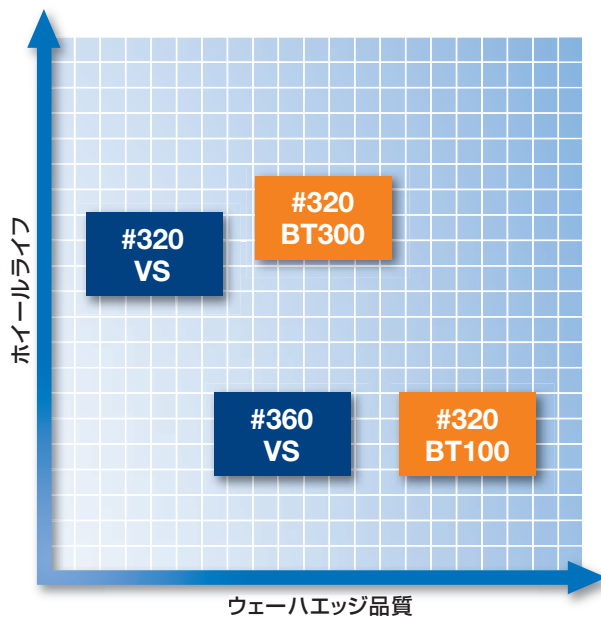
### 新開発レジンボンドの採用により1軸での高い研削クオリティを実現するBT100/BT300ボンド

新開発レジンボンドを採用することで、薄残し研削の課題であるエッジチッピング、研削ダメージを低減することができます。品質を重視したBT100ボンドとホイールライフを重視したBT300ボンドをラインアップし、ご要望に応じた選択を可能にしました。

- 新開発レジンボンドの採用により、高い研削クオリティを実現
- 新ホイール基台 (GF01) の採用により、効率的な研削水の供給を実現
- 品質重視のBT100、ホイールライフ重視のBT300をラインアップ



### ■ ボンド比較



加工対象 シリコンウェーハ、他

仕様

砥粒種類	特殊仕様	ホイール径 (mm)	チップ表記	チップ形状	チップ配列
SD 人造ダイヤ		200	ST	セグメント	標準
SDC コーティングダイヤ		300	SR	セグメント	真円
			WS	特殊	特殊

GF01 - SD 320 - BT100 - 50 - A\*\*\*\* 200 × 4W × 5T - ST

粒径	ボンド	集中度	チップ幅 (mm)	チップ高さ (mm)
320 #320	BT100	50	4.0	5.0
	BT300	50	4.0	5.0

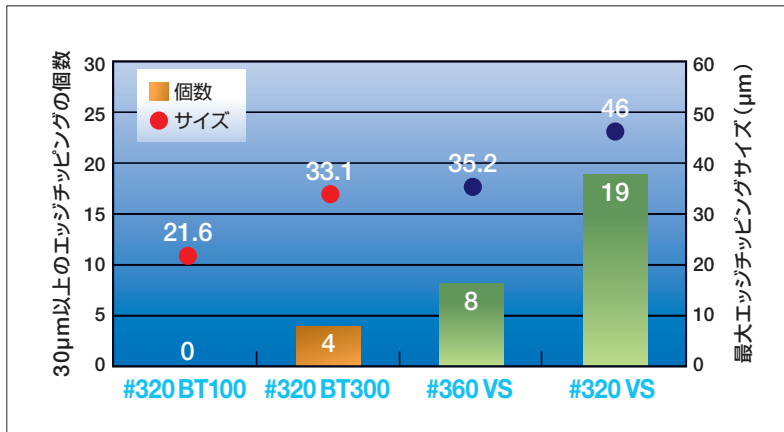
Grinding Wheels  
GF01 SERIES **BT100/BT300**



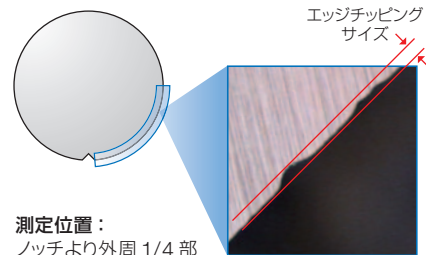
実験データ

BT100/BT300ボンドは、既存のビトリファイドボンドと比べ、エッジチッピングを低減することができます。

■エッジチッピング比較



ワーク : φ8" Siミラーウェーハ  
最終仕上げ厚さ : 100 μm  
Z2軸取り量 : 35 μm  
Z2軸使用ホイール : IF-01-1-4/6-B-K09



弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・ホイール径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。

・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますのでご確認の上、ご発注くださいますようお願い申し上げます。



安全にご使用いただくために

ブレード、ホイール(以下、精密加工ツール)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- 安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- 制限回転数表示のある精密加工ツールは指定の回転数を超えて使用しないでください。
- 精密加工ツールを装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- 精密加工ツールを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 使用する際には必ず毎回精密加工ツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 改造された機械(装置)は使用しないでください。
- 機械(装置)指定サイズに合わない精密加工ツールは使用しないでください。
- 切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- 湿式切断の精密加工ツールは冷却液をご使用ください。



株式会社 ディスコ

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11

Phone:03-4590-1000(営業代表) Fax:03-4590-1001 www.disco.co.jp